

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年6月12日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	开源证券、富国基金、中金证券、MLP、Orient Asset、RED GATE、施罗德投资、无极资本、胤胜资产、泰德圣投资、里思资产、硅谷天堂、沃隆港投资、南土资产、麦高自营、恒安标准人寿、金信基金、国君资管、Tenbagger、上海翀云私募、广发基金、招商银行、拾贝资产、淡水泉基金、麦高证券
活动时间	2024年6月12日
活动地点	策略会、反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、目前行业里 NOR Flash 产品有出现一些变化，公司对该产品线是如何考虑的？答：NOR Flash 作为通用型的存储产品，其销售价格主要受市场价格影响。公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行中高容量的 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。目前可以提供符合客户要求的最高至 1Gb 容量的 NOR Flash 产品。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。2、公司的封测成本是否有上调？答：公司已经与宏茂微、华润安盛、南茂科技、AT Semicon 等境内

	<p>外知名封测厂建立了稳定的合作关系，且封测成本占营业成本的比重相对较小，目前没有明显变化。3、WiFi7 方面公司是怎样的布局和规划？</p> <p>答：公司作为主营业务为利基型存储芯片的 IC 设计公司，选择 Wi-Fi7 芯片作为第二增长曲线。一方面公司希望从多方面进行产业链上下游的整合工作，尽可能多的在客户端导入公司更多产品，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，为客户提供更多样化的芯片解决方案，达到提升营收体量，分摊周期风险的目的；另一方面公司看到 Wi-Fi 芯片市场广阔的空间，特别是 Wi-Fi 6/7 在高带宽、高安全性、低延时以及对多设备同时接入有较高要求的场景具备明显优势，未来将成为 Wi-Fi 芯片市场增长的主要驱动力，伴随着智能手机、笔记本电脑、物联网 (IoT) 设备、智能家电和其他联网设备的使用不断增加，推动了对 Wi-Fi 芯片组的需求，并增加了对可靠、快速无线通信的需求。物联网 (IoT) 的普及导致各种应用对 Wi-Fi 芯片组的需求增加，包括可穿戴技术、智能家电、工业自动化、医疗设备等。随着互联网连接在发展中国家的普及，对低成本 Wi-Fi 设备的需求增加，未来也将推动 Wi-Fi 芯片市场的增长。4、公司 WiFi7 的研发团队如何组建的？团队的背景是什么？</p> <p>答：公司在半导体行业下行阶段积极接触行业上下游项目，经过审慎的考虑和对公司未来长期发展的规划选择通过建立控股子公司的方式进行 Wi-Fi 芯片的研发工作。团队成员均在国际或国内的一线通信芯片大厂有就职经验，熟悉国内射频、透传及 IOT 市场，致力于打造本土化的中高端的 Wi-Fi7 通信芯片。5、公司的 SLC NAND 从技术指标来看有哪些优势？</p> <p>答：公司聚焦平面型 SLC NAND Flash 的设计与研发，主要产品采用浮栅型工艺结构，存储容量覆盖 512Mb 至 32Gb，可灵活选择 SPI 或 PPI 类型接口，搭配 3.3V/1.8V 两种电压，可满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。公司 NAND Flash 产品核心技术优势明显，尤其是 SPI NAND Flash，公司采用了业内领先的单颗集成技术，将存储阵列、ECC 模块与接口模块统一集成在同一芯片内，有效节约了芯片面积，降低了产品成本，提高了公司产品的市场竞争力。公司产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定，不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过 10 万次，同时可在-40℃-105℃的极端环境下保持数据有效性长达 10 年，产品可靠性已逐步从工业级标准向车规级标准迈进。</p>
日期	2024 年 6 月 14 日